

ESPEC

COMNEX

第1回 次世代通信技術&ソリューション展

5G通信機器・デバイスの開発において、デバイスの発熱量増加を踏まえた信頼性試験や幅広い温度環境下での動作試験の実施が求められます。

エスペックでは、5G通信機器・デバイスの開発や設計、製造に役立つ多種多様な試験装置をご紹介します。

会期

2023年6月28日(水)～30日(金)
10:00～18:00 (最終日は17:00終了)

会場

東京ビッグサイト(西1ホール)

ブースNo.

6-2



出展予定製品

基地局/通信機器の評価

小型環境試験器 シールド仕様



温度範囲: $-40^{\circ}\text{C} \sim +100^{\circ}\text{C}$ の卓上タイプでシールド機能を有した恒温器。省スペースで端末、エッジデバイスの高/低温動作試験や温度特性試験時のEMC対策に最適です。

プリント実装基板/配線の評価

卓上型無風恒温槽

半導体デバイスやプリント実装基板の温度特性評価・熱解析の検証に最適な温度範囲: $-30^{\circ}\text{C} \sim +130^{\circ}\text{C}$ の卓上型無風恒温槽です。



電波暗箱型低温恒温器/恒温室

電波暗箱/室の機能と恒温槽/室の機能を兼ね備えた、電波無響環境下での温度環境試験が可能な複合環境試験器です。



スライド扉式小型環境試験器

卓上に設置可能なコンパクトサイズの恒温槽にスライド扉やインターフェイスの装備が可能です。配線距離の短縮が図れ、測定精度の向上、配線作業の簡易化などに優れた試験装置です。



高周波/高耐熱のコンデンサ・インダクタ評価、実装評価

コンデンサ・インダクタ温度特性評価試験装置



恒温槽内で広範囲の温度下において最大100MHzの周波数でインダクタンスや容量(C)測定をご提供。また、プローブシステムでの提案では、最大3GHzまでの周波数特性の取得が可能です。



低誘電材料/高耐圧絶縁評価システム

高温高湿環境と通電により絶縁不良を加速させ、抵抗値変化の測定により絶縁劣化を評価いたします。パソコンによる自動計測、データ収録およびデータ処理のシステム化によって、より正確な接続信頼性評価が可能です。

5G/IoTウェビナー
—— 公開中! ——

無料

視聴はこちらをクリック

5G・IoT Solution Expo
ESPEC

●エスペック製品や技術に関するお問い合わせは

カスタマーサポートデスク 0120-701-678

エスペック株式会社 <https://www.espec.co.jp/>

本社 530-8550 大阪市北区天神橋 3-5-6